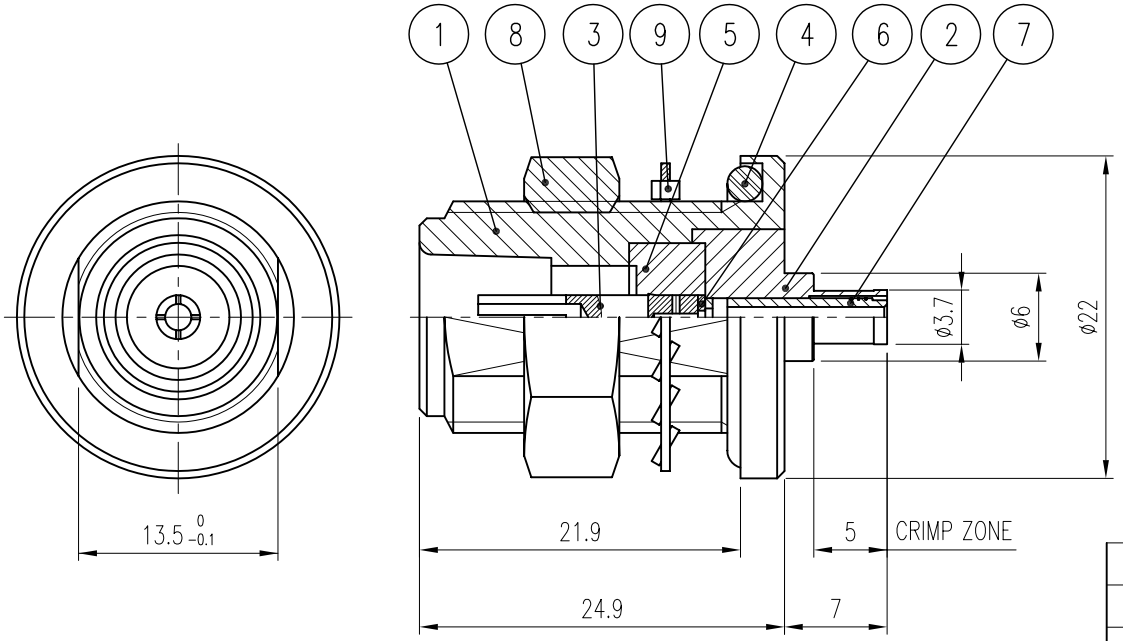
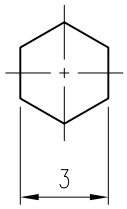
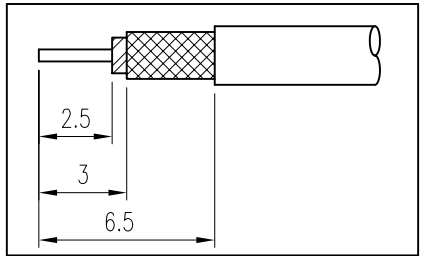
ST \ 기공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





Crimping Tool Size



CABLE 탈피도

품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
9	WASHER	1	MBsBD	Nickel Plate	DWA00045-5/1 (Q8018)
8	NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DNT00057-5/1
7	INSERT	1	MBsBD	Gold Plate	DIS00114-5/1
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01179-N/1
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01091-N/1 (H8242)
4	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00047-N/1 (G9006)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01386-5/1
2	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01789-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01788-5/1

조립 방법

1. 1번 BODY에 5번 TEFLON을 끼운 후 2번 BODY를 프레스 조립한다.
2. 조립 할 #54번 케이블에 7번 INSERT를 끼운다.
3. 위 조립을 한 케이블에 6번 TEFLON을 끼우고, 순서 1번 조립한 BODY를 끼운다.
4. 순서 3번 제품과 3번 CONTACT을 땜 한다.
5. N TYPE PIN 높이 지그를 이용 케이블을 삽입한다.
6. CRIMP ZONE에 육각3mm CRIMP TOOL을 이용하여 CRIMPING한다.

대체가능재질	년월일	2008. 2. 4.	KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	승인		
	검도		도명 N50-BJ-C-#54(MCB) VER.0
재질	제도		
열처리	작성부서	연 구 소	A4 도번 CN01215-7/1
보호피막처리	척도 5/1	단위 mm	중량